

企业需求信息	
需求名称	无
产业领域	电子信息
主要产品	无
企业名称	艾欧特（沈阳）科技有限公司
属 地	和平区
技术难题	需要解决的技术难题，需要获得的相关技术支撑，尽量将需求具体到技术关键点： 1，高温半导体和被动器件的漏电问题，导致非线性； 2，金属电迁移率的问题，需要用不同于传统的金属材料（如铝）进行尝试，比如：金属钨； 3，金属与金属之间的连接在高温时产生各种负效应反应，需要通过大量实验找到一种兼容的金属系统，解决封装问题； 4，传感器贴装于金属表面，除了解决高温忍受能力，由于CTE（热膨胀系数）的不同，将产生不同程度的迟滞效应。需要一种处于中间熔点的衬底材料，我们将尝试采用硫属化物玻璃； 5，在中国没有高分辨率的高温AD、DA和放大电路，我们有设计方法，但需要有的测试和一定量的试错过程； 6，另外，一个完整的高温晶圆代工厂在国内也是缺乏的，国内并没有提供高温制程（SOI、SiC、GaN）的晶圆厂。150℃以上的器件基本上都依赖从国外进口，而高温器件除了民用，更多的是工业和军用方面的需求，这也是目前比较敏感的话题。但这个问题并非靠一个公司就能解决，需要不同公司之间的共同协作，甚至得到中央政府的支持。西方国家尤其是美国，包括德国也拒绝将高温晶圆技术转移到中国，如果中国在这方面不

	能自主，那么诸如新能源汽车产业将步中兴、华为的后尘。 7, 使用ISPM阵列处理器技术的大数据分析平台或神经网络或人工智能，还需要SCACDA系统来完善物联网数据（主要为各种传感器数据）的采集的功能，这方面，东北大学将大有施展的空间。
企业简介	无
人才引进	所需人才的研究领域和专业、层级、人数等。资金需求：所需资金方式及额度，如风投、贷款、股权交易等。 政策需求：希望政府提供哪些针对性、实效性强的鼓励政策和措施： 人才需求：半导体工艺（3人）、数模混合集成电路设计（6人）、系统设计（5人）、软件工程（5人）、测试（3人）、结构设计（3人）、顶层架构项目带头人（2人）
科技金融	无
知识产权等需求	无
项目负责人	徐波
电 话	89724545